

平成 21 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社  
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員経営企画室長  
西村 永和  
TEL (075) 692 - 0251

## 中期経営計画「Revitalize “TOWA”」の策定について

世界経済の混乱は引き続き各産業に大きな影を落としており、とりわけ半導体産業においては業界再編にまで至る大きな打撃を受け、今なおその先行きは不透明な状況にあります。当社におきましては、平成 18 年 4 月に策定した中期経営計画「Challenge30」の遂行により、平成 19 年 3 月期、平成 20 年 3 月期と当初計画を上回る業績結果を残してまいりましたが、最終年度にあたる平成 21 年 3 月期に今回の世界経済危機に直面し、過去に経験したことのない急激な市場縮小により、大幅な計画未達を余儀なくされました。

そこで当社では、この環境下で得られた経験や反省をあらたな経営課題とすることに加え、新しく芽生えた「新技術」、「新ビジネス」をさらに洗練して大きく成長させるため、創立 30 周年を迎えるこの平成 21 年 4 月に、新中期経営計画「Revitalize “TOWA”」を策定いたしました。

当社はこの新中期経営計画を遂行し、株主様をはじめとするステークホルダーの方々から、さらに信頼とご満足をいただける「TOWA」を目指して、全力で取り組んでまいります。

### 記

#### 1. 新中期経営計画の基本方針

当社は、新中期経営計画「Revitalize “TOWA”」の基本方針を次のとおりに定めました。

##### 基本方針

モノ造りの原点に回帰して、「柔軟性のあるコスト構造」、「市況変動に即応できる生産体制」を築きあげるとともに、お客様のニーズを適時、適確に捉えたグローバルな営業展開を行なうことで、常に事業利益を確保する。

この基本方針に基づき、「基本戦略」、「事業別戦略」、「マーケット戦略」、「開発戦略」および「財務・管理戦略」を策定し、経営目標を達成するべく着実に遂行してまいります。

## 2. 新中期経営計画「Revitalize “TOWA”」の概要

### (1) 基本戦略

新中期経営計画は平成 21 年 4 月から平成 24 年 3 月までの 3 年間を計画期間としております。この計画期間の前半は、半導体産業において引き続き厳しい市場環境になることが予想されます。一方、LED や車載品等のパワー系デバイス、太陽電池等の産業ではさらに市場の拡大が予想され、その速度、規模ともにこれまでの水準を上回る伸張が予想されます。

以上のことから当社では、新中期経営計画の基本戦略を次のとおりといたしました。

#### ①受注環境にあわせた経費コントロールを実施し、「黒字」を確保する

当社の事業ポートフォリオは半導体事業がその大半を占めており、半導体モールドイング装置では世界トップシェアを維持していることから、半導体市況が回復さえすれば当社の受注環境は時間を要せず好転するものと思われま。しかしながら、現時点ではその回復の時期が不透明であり、当面は厳しい受注環境にも対応できる体制が必要とされます。当社はすでに、人件費削減や一時帰休の実施を含めた大幅な固定費削減策を実行しており、受注動向にあわせた固定費のコントロールが可能な体制を整えております。半導体市況の回復が本格化するまではこの体制を継続し、その回復が大幅に遅れたとしても黒字を確保できるよう損益管理を行なってまいります。

#### ②事業ポートフォリオの見直し

半導体市況の変動は大きく、当社の業績もその動向に大きく左右される状況にあります。当社では半導体事業で培った「金型関連技術」や「封止技術」を半導体以外の事業に展開することで新しい事業分野を開拓し、事業ポートフォリオに占める半導体事業の比率を結果的に下げることで、業績の変動幅の引き下げを図ります。具体的には、すでに立ち上げに成功した「LED 事業」をさらに発展させることはもちろん、車載品や、パワー系デバイス、太陽電池等においても、当社の最先端技術を用いたソリューションを提供し、その早期事業化に取り組んでまいります。

#### ③半導体モールドイング装置での圧倒的な市場シェアを目指す

従来の半導体製造工程においては、その「前工程」において差別化が成されることが大半でありました。しかしながら、基板の大型化やチップの薄型化、多層化が進み、WLP（ウェハレベルパッケージ）が現実のものとなった今、「後工程」分野への技術要請は格段に高い水準となり、コスト面も含めて「後工程」において差別化が成される時代となりました。当社では、コア・コンピタンスである金型関連技術に独自の封止技術を加え、半導体モールドイング装置市場の更なる寡占化をはかり、市場シェア 50%以上を目指します。

## (2)事業別戦略

当社の事業別戦略を大きく「半導体モールドイング事業」、「シンギュレーション事業」、「LED 事業」、「化成品事業」に分けて、次のとおりに展開いたします。

### ①半導体モールドイング事業

当社は、従来の「トランスファー方式」に代わる新しい封止技術として「コンプレッション方式」を確立いたしました。半導体各社のパッケージ開発の方向性を見れば、従来の封止技術では対応できないものが多く、その実現にはコンプレッション方式の採用が必要になるものと予想されます。当社ではコンプレッション方式を採用した新製品「PMC」を昨年末に市場に投入しており、半導体市場が縮小している時期ではあるものの、客先での評価や R&D における新しいパッケージへの対応テスト等、その技術の市場浸透を積極的に進めてまいります。これにより、多段スタックや WLP 等ハイエンドのパッケージや、従来パッケージのコストダウン用として、他社との大きな差別化が可能となり、市況が好転する時期には半導体モールドイング装置市場で圧倒的なシェアを確保することができると考えております。

### ②シンギュレーション事業

半導体モールドイング事業とシンギュレーション事業との関係は密接であり、モールドイング後のパッケージの個片化はユーザーにとって不可欠なものであることから、当社はこの市場でさらなるシェアアップに注力することといたしました。すでに当社独自のコンセプトと機能を備えた新製品「FMS」の開発を完了しており、本格的に市場投入してまいります。また、LED の分野においても個片化の需要は旺盛にあり、LED 対応のシンギュレーション市場にも注力してまいります。

### ③LED 事業（重点戦略事業）

「環境」、「省電力」、「長寿命」等の観点から、光源の LED 化は着実に進んでおり、その市場規模は引き続き成長を続けております。すでにノート PC では液晶画面のバックライトに LED を採用したモデルが多数販売されていますが、今後はバックライトに LED を採用した「液晶テレビ」が本格的に市場投入されます。これにより LED の市場はさらに膨らむとともに、各社の量産によるコストダウンがそのスピードを速めるものと考えられます。そこで当社では、この LED 事業を「重点戦略事業」と位置付け、あらたな事業の「柱」として事業ポートフォリオに占める比率を積極的に引き上げてまいります。

### ④化成品事業

医療用器具等に使われる当社のプラスチック成形品は、その用途も広く、安定した受注を得ています。また、ユーザーの生産方針が一部国内にシフトしつつあることから、今後もこの市場は需要旺盛と考えられます。当社では、現在のユーザーからの信頼を維持し、安定した受注を確保していく方針です。

### (3)マーケット戦略

当社の主要な顧客には台湾、中国等のアSEMBリーハウスが多く、台湾マーケットにおいては寡占的なシェアを持っておりませんが、IDM（半導体一貫メーカー）との取引拡大も重要な課題と考えております。また、地理的にもあらたな地域に半導体後工程の市場が立ち上がりつつあり、その地域の早期の顧客囲い込みが重要な戦略となっています。

以上のことから当社では、マーケット戦略として取り組む課題を次のとおりとし、3年間にわたり目標の達成と課題の克服に向けて取り組んでまいります。

#### ①中国マーケットへの取り組み

中国市場はまだ未成熟な市場ながら、半導体やLED事業におけるその潜在市場規模は極めて大きなものと考えられます。すでに当社の主要顧客である台湾系のアSEMBリーハウスは中国本土への進出を開始しており、台湾と中国の地理的な市場の分離がなくなりつつあります。また、中国政府が実施する「家電下郷」政策等により、中国ローカルの各メーカーが設備投資を活発化させることも予想されています。従いまして当社では、従来からの顧客の中国本土進出による設備投資を確実に捕捉するとともに、中国ローカルメーカーの設備投資動向の情報を収集し、アプローチを開始いたします。これにより中国ローカルのマーケットにおいてもその設備投資を確実に受注につなげ、当社の装置を早期にスタンダード化させることによる顧客の囲い込みを実現してまいります。

#### ②世界主要IDMの攻略

当社はアSEMBリーハウスとの取引に加え、IDMとの取引拡大にも注力してまいります。パッケージのプロセス開発から共同で行なうことや、コンプレッション技術を用いたハイレベルのソリューションを提供すること等により、IDMとの強固な関係を築いてまいります。

#### ③成長産業への取り組み

環境への取り組みが大きなビジネスになる時代となり、太陽電池や電気自動車のマーケットを初め、今後大きな成長が予想される「時流の産業」において使われるデバイスを徹底的に調査いたします。この取り組みに対しては「マーケティング」を専門に行なう部署を立ち上げ、デバイスに含まれる封止工程や精密金属加工などのプロセスにおいて、当社の技術を応用できる事業分野を模索してまいります。

#### (4)開発戦略

すでに市場から高い評価を得ているコンプレッション方式による新製品をさらに洗練させるとともに、各ユーザーから寄せられる、よりハイレベルの技術要求に応えるべく、金型の新素材やそのプレス機構の開発、超精密加工技術（マイクロナノ加工）を応用したソリューションの提供等、引き続き世界最先端をフィールドにした「TOWA」であり続けるために、様々な開発に Challenge してまいります。

#### (5)財務・管理戦略

財務・管理部門においては「キャッシュフロー管理」を最重要課題として取り組みます。売上債権、在庫の回転期間を短縮するため、回収管理、プラットフォーム在庫の水準管理を徹底し、所要運転資金の引き下げに注力いたします。これにより、フリーキャッシュフローを每期確実に確保し、有利子負債 100 億円以下を目指します。

また、すでに進めている大規模なコスト削減策により、業務の効率化や事業拠点の見直しを行い、人員配置についても抜本的に見直しいたします。これにより「単体 400 名、連結 900 名」を目指す体制整備に努めてまいります。

### 3. 経営目標（業績計画）

3カ年の経営目標（業績計画）を以下のとおりとし、新中期経営計画「Revitalize “TOWA”」において取り組む「戦略」や「課題」を着実に遂行することにより、目標（業績計画）の達成を目指してまいります。

（単位：百万円）

項 目		期 別				
		平成20年3月期 （実績）	平成21年3月期 （予想）	平成22年3月期 （計画）	平成23年3月期 （計画）	平成24年3月期 （計画）
売 上 高		25,753	11,000	11,500	15,000	20,000
売 上 高 内 訳	半導体製造用等精密金型	8,674	4,300	3,500	4,500	6,000
	モールディング装置	13,506	3,500	3,300	4,800	6,300
	LED装置(含むLED金型)	1,042	1,200	2,000	2,500	3,500
	シンギュレーション装置	1,216	800	1,200	1,500	2,000
	ファインプラスチック成形品	1,313	1,200	1,200	1,200	1,200
	その他装置等	—	—	300	500	1,000
経 常 利 益		2,125	△3,700	100	500	1,500
当 期 純 利 益		2,118	△4,000	100	500	1,500

なお、上記の予想は現時点において入手可能な情報、および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時点における仮定を前提としています。従いまして実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありますのでご承知おき頂きますようお願いいたします。